

06/IMDIA/1/18
2018年1月12日

会員各位殿

 IMDIA会長 高橋 誠
(人材育成委員会)

2017年度Mold金型保全上級ワークショップ実施の件

拝啓

時下、益々ご清栄の段、心よりお喜び申し上げます。

インドネシア金型工業会に、ご支援、ご協力頂きまして、誠にありがとうございます。インドネシアと日本とのEPAが2008年7月1日から発効しており、その一環としてJETROからの支援によりまして、標記Mold金型保全上級ワークショップをIMDIA JETRO委員会のサポートにより、以下の内容で実施しますので、ご参加をお願いします。

- 1.目的 : Mold金型保全上級育成プログラムにより、Mold金型保全作業の中で同じ故障が2度と起きない様な改善保全を行い、次に故障が起きる前に未然に防ぐ予防保全作業の習得をを目指す。認定試験は上級に必要な保全知識と改善保全プロセスのテーマ研修により評価を行う。優秀者にはHIDA公認IMDIA認定書を授与する。
- 2.対象者 : Mold金型保全中級認定者
- 3.募集 : 2018年1月12～2月2日 12:00まで
(本ワークショップに参加する応募者が10名になりましたら自動的に閉め切りとさせていただきます)

実施期間・場所	実施期間	実施場所	住所
	2018年2月8日、9日	理論	YMG- Techno School, Jl. Raya Bogor Km. 29, Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta, 13710 Indonesia
	3月21日～23日	発表会、学科試験	

- 5.講師 : JETRO Mold金型保全専門家 住田 安弘
- 6.費用 : 会員:無料
非会員:1,500,000Rp
- 7.受講者 : 参加者数は年会費により以下の通りとなります。

年会費	個人会員	2.000.000	3.000.000	4.000.000	#####
参加者数	本人のみ	3名	4名	5名	6名

 参加します。 参加しません。

なお返送は勝手ではありますが、参加・不参加に関わらず、2018年2月2日(金) 12:00までにメールにてお願いします。

返事メール: Ms. Cipty (cipty@imdia.or.id)

(参加の場合は以下に、ご記入下さい)

 会社名 :

(なお個人会員は本人のみとなります)

参加氏名	氏名	携帯電話番号
1		
2		
3		
4		
5		

 Bahasa Indonesia di sheet selanjutnya [or click here](#)